

認証書付属書（異板厚）

表 1 認証試験板厚の溶接条件データ
（最小及び最大ルート間隔の場合）

梁フラッグ板厚 (mm)	通しダイヤフラム 板厚 (mm)	最小、最大 ルート間隔 (mm)	溶接電流範囲 (A)	溶接電圧範囲 (V)	溶接速度範囲 (c p m)	パス数
	表面段差 (mm)					
12×19	3.0	4～10テーパ	250～330	29～36	24～30	4
		10	250～330	29～36	24～30	
32×45	9.0	4～10テーパ	270～360	30～37	19～35	12
		10	270～360	30～37	19～35	

定常状態の溶接条件データ測定値を記載している。

表 2 認証試験時データから想定された溶接施工条件範囲（表面段差 ≤ 2.0mm）

梁フラッグ板厚 (mm)	表面段差 (mm)	最小 6 mm、最大 ルート間隔 (mm)	溶接電流範囲 (A)	溶接電圧範囲 (V)	溶接速度範囲 (c p m)	パス数
9	2.0 以下	4	230～350	25～39	20～40	2
		6	230～350	25～39	15～35	
		10	230～350	25～39	15～30	
12	2.0 以下	4	230～350	25～39	20～40	3
		6	230～350	25～39	15～35	
		10	230～350	25～39	15～30	
16	2.0 以下	4	240～360	25～41	20～55	4
		6	240～360	25～41	15～50	
		10	240～360	25～41	15～40	
19	2.0 以下	4	240～380	25～41	20～55	5
		6	240～380	25～41	15～50	
		10	240～380	25～41	15～40	
22	2.0 以下	4	240～400	25～42	20～55	5
		6	240～400	25～42	15～50	
		10	240～400	25～42	15～40	
25	2.0 以下	4	240～400	25～42	20～55	7
		6	240～400	25～42	15～50	
		10	240～400	25～42	15～40	
28	2.0 以下	4	240～400	25～42	20～55	8
		6	240～400	25～42	15～50	
		10	240～400	25～42	15～40	
32	2.0 以下	4	240～400	25～42	20～55	10
		6	240～400	25～42	15～50	
		10	240～400	25～42	15～40	
36	2.0 以下	4	240～400	25～42	20～55	13
		6	240～400	25～42	15～50	
		10	240～400	25～42	15～40	
40	2.0 以下	4	240～400	25～42	20～55	15
		6	240～400	25～42	15～50	
		10	240～400	25～42	15～40	

パス数は、表 1 および表 2 に記載の 10%増までのパス数を認める（小数点以下は切上げ）。

- ※ この溶接施工条件範囲は、認証証に記載された溶接条件(40kJ/cm 以下、YGW11：パス間温度 250℃以下、YGW18：パス間温度 350℃以下)で使用しなければならない。
- ※ 裏当て金とダイヤフラムのかかりは4.0mm を標準とする。
- ※ 鉄骨システムソフトウェア Ver 4 以降

表3 認証試験時データから想定された溶接施工条件範囲 (2.0mm < 表面段差 ≤ 5.0mm)

梁フラッシュ板厚 (mm)	表面段差 (mm)	最小 6 mm、最大 ルート間隔 (mm)	溶接電流範囲 (A)	溶接電圧範囲 (V)	溶接速度範囲 (c p m)	パス数
9	3.0以下	4	230～350	25～39	20～40	3
		6	230～350	25～39	15～35	
		10	230～350	25～39	15～30	
12	3.0以下	4	230～350	25～39	20～40	4
		6	230～350	25～39	15～35	
		10	230～350	25～39	15～30	
16	5.0以下	4	240～360	25～41	20～55	5
		6	240～360	25～41	15～50	
		10	240～360	25～41	15～40	
19	5.0以下	4	240～380	25～41	20～55	5
		6	240～380	25～41	15～50	
		10	240～380	25～41	15～40	
22	5.0以下	4	240～400	25～42	20～55	6
		6	240～400	25～42	15～50	
		10	240～400	25～42	15～40	
25	5.0以下	4	240～400	25～42	20～55	8
		6	240～400	25～42	15～50	
		10	240～400	25～42	15～40	
28	5.0以下	4	240～400	25～42	20～55	9
		6	240～400	25～42	15～50	
		10	240～400	25～42	15～40	
32	5.0以下	4	240～400	25～42	20～55	11
		6	240～400	25～42	15～50	
		10	240～400	25～42	15～40	
36	5.0以下	4	240～400	25～42	20～55	13
		6	240～400	25～42	15～50	
		10	240～400	25～42	15～40	
40	5.0以下	4	240～400	25～42	20～55	15
		6	240～400	25～42	15～50	
		10	240～400	25～42	15～40	

パス数は、表1および表2に記載の10%増までのパス数を認める（小数点以下は切上げ）。

※ この溶接施工条件範囲は、認証証に記載された溶接条件(40kJ/cm 以下、YGW11：パス間温度 250℃以下、YGW18：パス間温度 350℃以下)で使用しなければならない。

※ 裏当て金とダイアフラムのかかりは4.0mmを標準とする。

※ 鉄骨システムソフトウェア Ver 4 以降

表 4 認証試験時データから想定された溶接施工条件範囲 (5.0mm < 表面段差)

梁フラッシュ板厚 (mm)	表面段差 (mm)	最小 6 mm、最大 ルート間隔 (mm)	溶接電流範囲 (A)	溶接電圧範囲 (V)	溶接速度範囲 (c p m)	パス数
9	3.0 以下	4	230～350	25～39	20～40	3
		6	230～350	25～39	15～35	
		10	230～350	25～39	15～30	
12	3.0 以下	4	230～350	25～39	20～40	4
		6	230～350	25～39	15～35	
		10	230～350	25～39	15～30	
16	5.0 以下	4	240～360	25～41	20～55	5
		6	240～360	25～41	15～50	
		10	240～360	25～41	15～40	
19	5.0 以下	4	240～380	25～41	20～55	5
		6	240～380	25～41	15～50	
		10	240～380	25～41	15～40	
22	6.0 以下	4	240～400	25～42	20～55	8
		6	240～400	25～42	15～50	
		10	240～400	25～42	15～40	
25	7.0 以下	4	240～400	25～42	20～55	10
		6	240～400	25～42	15～50	
		10	240～400	25～42	15～40	
28	8.0 以下	4	240～400	25～42	20～55	10
		6	240～400	25～42	15～50	
		10	240～400	25～42	15～40	
32	9.0 以下	4	240～400	25～42	20～55	12
		6	240～400	25～42	15～50	
		10	240～400	25～42	15～40	
36	10.0 以下	4	240～400	25～42	20～55	14
		6	240～400	25～42	15～50	
		10	240～400	25～42	15～40	
40	11.0 以下	4	240～400	25～42	20～55	16
		6	240～400	25～42	15～50	
		10	240～400	25～42	15～40	

パス数は、表 1 および表 2 に記載の 10% 増までのパス数を認める（小数点以下は切上げ）。

※ この溶接施工条件範囲は、認証証に記載された溶接条件 (40kJ/cm 以下、YGW11：パス間温度 250℃以下、YGW18：パス間温度 350℃以下) で使用しなければならない。

※ 裏当て金とダイアフラムのかかりは 4.0mm を標準とする。

※ 鉄骨システムソフトウェア Ver 4 以降